经济要闻

1.工业和信息化部：印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见(2026—2028 年)》。到 2028 年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局，信息通信智能运营和服务能力达到国际先进水平，形成 30 个以上高价值典型场景，城域算力 1 毫秒时延圈覆盖率不低于 75%。具体措施包括：加强高端光电芯片和器件研发，加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证；夯实网络支撑底座，加快建设 400Gbps/800Gbps 等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输通道，构建城域毫秒级低时延入算能力。（资料来源：i

2.商务部、文化和旅游部、国铁集团等：印发《关于促进铁路与旅游融合发展扩大服务消费的若干措施》，提出 15 项具体举措。到 2030 年，在全国范围内打造 160 列以上铁路旅游列车专用车组。（资料来源：i

3.税务总局：6 月 10 日，公开相关信息显示，1—5 月份累计补缴税款约 130 亿元，税务机关加强对居民个人境外所得的宣传引导和政策辅导，取得境外收入的纳税人遵从度明显提高。（资料来源：i

4.外交部：6 月 10 日，发言人林剑就美伊局势升级表示，中方对当前的伊朗局势深表关切，相关各方应保持冷静克制，停止激化矛盾、升级局势，采取切实的措施缓局降温，坚持通过政治外交途径化解争端，尽早实现全面持久停火。（资料来源：i

5.铁路部门：积极适应旅客家庭出行、亲子旅游的需求，创新客运产品供给，6 月 11 日起儿童旅客可购买铁路旅游计次票，并享受儿童优惠票政策，亲子、家庭旅游出行更加便捷实惠，将有力促进铁旅融合发展和服务消费扩能提质。（资料来源：i

6.中国汽车工业协会：6 月 10 日，发布数据显示，2026 年 5 月，我国新能源汽车市场企稳回升，产销分别完成 155.4 万辆和 149.6 万辆，同比分别增长 22.4%和 14.4%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例进一步提升，达到 56.9%。1—5 月，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.5%。（资料来源：i

7.国家数据局：6 月 11 日，举行新闻发布会，相关负责人在会上介绍，“数据要素×”三年行动取得阶段性成效，我国企业数据产品和服务的数量和交易额实现双增长。据介绍，《“数据要素×”三年行动计划》是国家数据局成立后会同有关部门推出的首份政策文件，旨在推动数据要素在相关行业和领域的广泛应用。（资料来源：i

8.欧盟：英国《金融时报》9 日报道，欧盟希望劝说七国集团推迟上调俄罗斯石油价格上限，以阻止俄罗斯“吃到”国际原油价格高企的“红利”。（资料来源：i

9.巴西：全国谷物出口商协会(ANEC)表示，2026 年 6 月份巴西豆粕出口量估计为 231 万吨，高于一周前预估的 165 万吨，也高于去年 6 月的 167 万吨。（资料来源：i

本期编辑

分析师：莫文娟

010-66555574 mowj@dxzq.net.cn

执业证书编号：S1480524070001

东兴证券研究所金股推荐

证券代码	证券简称
002182.SZ	宝武镁业
002392.SZ	北京利尔
002436.SZ	兴森科技
600487.SH	亨通光电
603345.SH	安井食品
603678.SH	火炬电子
603979.SH	金诚信
688531.SH	日联科技

数据来源：《六月金股汇》2026 年 06 月 01 日，东兴证券研究所

10.美国财政部：10 日发布的月度财政数据显示，美国联邦政府 5 月关税退款金额接近 220 亿美元，当月美国海关关税净收入为负数。数据显示，美国 5 月海关关税总收入为 219.3 亿美元，关税退款金额达 219.72 亿美元，这意味着扣除关税退款后，当月关税净收入为负 4200 万美元。(资料来源：i

重要公司资讯

1.阿里巴巴：6 月 11 日，宣布钉钉管理层调整，陈航卸任钉钉 CEO，出生于 1992 年的陈宇森接棒。（资料来源：i

2.SK 海力士：计划到 2034 年将晶圆产能提高两倍，以满足日益增长的由人工智能驱动的内存芯片需求。SK 集团还计划与英伟达合作，在 2028 年至 2029 年间在日本建设一座 AI 数据中心。（资料来源：i

3.Omdia：6 月 11 日，在半导体行业创下历史新高的一年之后，新年伊始依然延续了强劲的增长势头。根据 Omdia 的最新研究，2026 年第一季度的半导体营收较 2025 年第四季度环比增长 27%，达到 3190 亿美元。存储器营收是推动这一增长的主要动力，其在 2026 年第一季度的环比增幅超过 80%。（资料来源：i

4.零跑汽车：6 月 11 日，据 Dataforce 最新数据显示，2026 年 5 月，零跑汽车在意大利纯电动汽车市场继续领跑，单月上牌量达 4,765 台，同比增长 1,278%；纯电市场占有率攀升至 34.5%，创历史新高；私人渠道市占率高达 48%，稳居第一。（资料来源：i

5.星展：6 月 11 日，新加坡星展集团计划推出代币化实物黄金产品，以顺应市场对数字黄金资产日益增长的需求。该行表示，此产品为新加坡首个面向零售客户推出的代币化实物黄金服务，允许用户通过数字方式获取、持有和交易黄金代币。（资料来源：今日头条）

每日研报

【东兴通信】光互联 CPO 行业：产业化提速，台积电 COUPE 引领硅光集成落地——（20260607）

当下 CPO 已经成为光模块行业确定趋势。传统方案是采用可插拔光模块，部署在交换机前面板。但根据 AI 网络带宽的发展路线图，互连的速度、距离、密度及可靠性要求即将超越传统光模块所能提供的极限。为突破上述局限，CPO（光电共封装）已成为业界公认的 AI 及超算高密度互连终极方案，其通过将光引擎 OE（OpticalEngine）和交换芯片 ASIC 共基板封装在一起，实现极致能效、带宽密度与低时延。

CPO 方案将带动全球硅光子（SiPh）产业链迎来发展拐点。过往硅光子依托 CMOS 工艺实现光电器件集成，处于小批量定制化阶段，始终缺乏大规模落地场景。而 CPO 则是硅光子规模化落地的刚需载体。受益于英伟达 Spectrum-X 以太网硅光技术 2026 年 6 月全面量产，CPO 技术有望在 2027 年迎来规模化部署。硅光子 SiPh 产业链可以拆解为“材料-器件-封测-系统”四个层级。其中底层是材料层，主要包括热界面材料、底部填充材料、积层膜、玻璃芯基板、紫外胶等；第二层是核心有源及无源器件，主要包括散热部件、光学部件（波导、光纤、超构透镜）、激光源、光纤阵列单元等；第三层是代工制造与封测层，主要包括光学封装平台、电芯片测试、光芯片测试与耦合等；最后一层是系统模块，主要包括 CPO 光引擎以及 CPO 交换机芯片模组。

CPO 市场 2027 年有望突破 50 亿美元。LightCounting 在 2026 年 4 月对 1.6TCPO 产品出货量进行显著上调。2023-2026 年，1.6TCPO 产品为技术导入期，出货量几乎为零，处于试点部署阶段；2027 年起进入大规模放量阶段，增长曲线陡峭上扬，2029 年 1.6TCPO 产品出货量预测从约 200 万个大幅上调至约 900 万个，2031 年则从约 500 万个上调至约 1300 万个。市场规模方面，CPO 市场 2027 年有望突破 50 亿美元，2030 年增长至 150 亿美元。

台积电 COUPE 平台实现光引擎先进 3D 异质集成。COUPE 平台把先进逻辑工艺（7nm 甚至更先进）的电子集成电路（EIC）直接堆叠在 65nmSOI 硅光工艺的光子集成电路（PIC）顶部，通过铜-铜混合键合互连，信号路径从毫米级缩短到微米级，是仅次于 3D 单片集成下的最短走线长度方案，技术路线处于行业领先地位。

COUPE 平台提供 PIC 制造全面解决方案。在工艺优化层面，台积电采用光学邻近校正（OPC）技术，通过添加亚分辨率的辅助图形，或调整原始图形的尺寸与形状，补偿光刻与刻蚀过程中产生的图形畸变，大幅提升了器件的性能一致性与良率。在晶圆加工全流程中监测器件整体状态与性能，实现生产工艺和器件性能之间闭环反馈。COUPE 对硅光器件线宽实施均匀度监控与优化，从而保障器件整体性能。COUPEPDK 提供了覆盖 O 波段的完整 Si/SiN 无源与有源光器件库，为光子芯片设计提供了完整的基础模块。

台积电 COUPE 平台研制的核心器件实现优异的性能指标。无源器件方面，COUPE 平台硅基无源器件覆盖 1290－1330nm 波长范围，包括高带宽、低损耗的波导、光栅耦合器、边缘耦合器、多模干涉仪和定向耦合器。在光栅耦合器方面，纯硅 SPGC 的峰值损耗约 1.3dB；基于 SiN/Si 复合结构的 SPGC，纯硅 PSGC 的 TE 与 TM 模式峰值损耗约 2dB。在调制器与探测器方面，COUPE 平台提供多种 MRM 结型设计，适配不同的应用场景；锗光电探测器具备高响应度、超高速、低暗电流特性；双微环谐振器相比传统的单微环谐振器，实现了更优异的带外抑制性能，串扰水平大幅优化。

台积电 COUPE 平台实现技术落地与迭代，绑定标杆客户。2026 年 4 月，台积电 COUPE 平台经过反复仿真与制程优化，已转化为完整的半导体制程技术。COUPE 平台技术路线分三步走，产品性能与集成度逐级跃升。其中 2026 年实现基于台积电 CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）中介层技术的共封装光学（CPO），光学引擎直接集成在交换机基板上；规格为 6.4Tbps 光学引擎。2026 年 6 月，基于台积电 COUPE 平台，英伟达新一代 CPO 交换机 Spectrum-X 实现量产。此外英伟达 COUPE 平台并不局限于单一的垂直整合生态系统。博通 Tomahawk6Davisson 交换机也将采用基于台积电 COUPE 的光引擎。

投资策略：

我们认为，CPO 生态逐步形成，台积电与英伟达暂处于领先地位。但博通、英特尔、Marvell、AyarLabs、三星等 CPO 解决方案厂商以及格芯、TowerSemi、意法半导体等硅光子代工平台也将加大研发，驱动硅光子产业加速发展。此外全球硅光子将从碎片化定制研发转向标准化代工量产模式。国内硅光新材料、无源以及有源器件、以硅光器件设计套件（PDK）、集成测试等厂商有望进入英伟达、台积电供应链体系，加速硅光子国产化验证与量产落地。

相关公司：

光模块、CPO/NPO：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技；

光芯片：源杰科技、东山精密、仕佳光子、长光华芯；

OCS：腾景科技、福晶科技、矩光科技、德科立；

CPO 设备：联讯仪器、罗博特科。

风险提示：（1）CPO 技术路线碎片化；（2）CPO 订单不及预期；（3）光模块产能过剩与价格下行；（4）供应链与地缘风险。

（分析师：石伟晶　执业编码：S1480518080001　电话：021-25102907）

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

以上内容来源于东兴证券研究报告的观点。

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及报告作者在自身所知情的范围内，与本报告所评价或推荐的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，我公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。

行业评级体系

公司投资评级（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数）：

以报告日后的 6 个月内，公司股价相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；

推荐：相对强于市场基准指数收益率 5%～15%之间；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%～+5%之间；

回避：相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。

行业投资评级（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数）：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准指数的表现为标准定义：

看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；

中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%～+5%之间；

看淡：相对弱于市场基准指数收益率 5%以上。